

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

南京冠石科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 战略发布会
参与单位名称及人员姓名	1、国泰君安：陈豪杰 2、张子豪-东证资管 3、胡守正-光证资管 4、段然-宏道投资 5、侯文佳-西部利得基金 6、郭航-泓德基金 7、吴春林-南方基金	
时间	2023年6月2日 10:30--11:30	
地点	公司会议室电话交流	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王顺利；技术负责人：陈新晋；财务总监：潘心月；证券事务代表：李蕾	
投资者关系活动主要内容介绍	2023年6月2日上午,投资者通过电话会议的方式,与公司进行沟通交流,主要内容如下: 1. 半导体产业链上游核心材料的发展趋势	

目前我国半导体产业链存在“全而不强”的现状，即产业链中关键环节的技术水平与国际先进水平相比仍有较大差距，核心产品国产化率较低，产业链上下游企业缺乏深度联系。在地缘政治、国际贸易争端、技术封锁等多重因素的叠加影响下，实现全产业链国产化替代及自主可控、打破国外垄断局面、培育良好产业生态、打通产业内循环已成为我国半导体行业发展的必然趋势。

2、本次募投项目的基本情况？

公司本次募集资金投资项目为“光掩膜版制造项目”，主要产品为半导体光掩膜版，系半导体产业链上游核心材料之一。基于产品用途的不同，光掩膜版主要应用于 IC、FPD、PCB、MEMS 等领域。主要针对 IC 端，是芯片制造中光刻工艺所使用的图形母版，可承载图形设计和工艺技术等知识产权信息，通过曝光将掩膜版上的电路图案转印到芯片上，从而实现芯片的批量化生产。

项目建成以后，将具备年产 12,450 片半导体光掩膜版的生产能力，产品制程覆盖 350-28nm（其中以 45-28nm 成熟制程为主），系市场主流中高端产品，可广泛应用于高性能计算、人工智能、移动通信、智能电网、高速铁路、新能源汽车、消费类电子等众多产业涉及的集成电路半导体领域，能够满足多类晶圆设计、晶圆代工企业的采购需求，以及先进半导体芯片封装、半导体器件等产品的应用需求。

	<p>3. 募投项目的建设及生产计划?</p> <p>项目总建设期为 5 年，不同制程的光掩膜版达产时间主要取决于设备交期，首批设备交付后预计 2025 年公司即可实现 45nm 光掩膜版的量产，待全部设备交付后预计 2028 年可实现 28nm 光掩膜版的量产。</p> <p>4. 公司的技术研发能力?</p> <p>公司在半导体光掩膜版制造领域已组建专业的技术团队，核心骨干人员曾就职于业内知名光掩膜厂，在光掩膜版领域具有扎实的技术研发能力以及丰富的生产制造经验。技术团队主要成员均在半导体行业龙头企业工作多年，在半导体光掩膜版领域拥有丰富的研发、生产、管理经验及行业资源，掌握了产品技术研发、生产制造、质量管控等方面的大量 Know-How，具备较强的自主研发能力，可以助力本次募投项目顺利落地。</p> <p>5. 公司的主营业务现状?</p> <p>公司主营业务为半导体显示器件、特种胶粘材料及其他，22 年营收 11.08 亿，净利润 0.82 亿。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 6 月 2 日